

2009 年 2 月 13 日

お客様各位



Comm&CE 事業部 Comm&CE1 部

新田 勝規

Freescal Semiconductor 社製品の一部内装箱変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。また、日頃より格別なるご愛顧を頂き、誠にありがとうございます。

さて、Freescal Semiconductor 社製品納品時の内装箱に関しまして、一部変更いたしますので宜しくお願い申し上げます。

記

内容：

お客様ご注文数量に合わせる為の弊社小分け時に使用しておりました内装箱を Freescal Semiconductor 社ロゴ入り内装箱から無地の内装箱に変更いたします。

変更理由：

弊社梱包部材共通化のため。

変更日：

2009 年 4 月頃より

対象製品：

Freescal Semiconductor 社製品トレイ梱包全品

変更に伴う影響：

品質、信頼性、電気特性等今回の変更による影響はございません。

■変更前■



■変更後■



以上